＜ニュースリリース＞

平成１８年 ９ 月 ８ 日

各　　位

会　社　名　大成ラミック株式会社
代表者の役職氏名　代表取締役社長　木村　登
（コード番号：４９９４　東証第一部）
問合せ先　専務取締役管理本部長　木村義成
電話番号　０４８０－９７－０２２４

開発成果等の譲受契約締結に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、日本精機株式会社と液体・粘体充填機の開発成果等の譲り受けに関する契約の締結について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．契約締結の理由

当社は液体・粘体包装フィルムの製造・販売を主力事業とし、この液体・粘体包装フィルムに内容物を充填する液体・粘体充填機を日本精機株式会社と共同で開発、日本国内での販売および保守メンテナンスを行っております。

今般、日本精機株式会社の事業部再編・統合にあたり、同社が所有する特許権等の開発成果、関連動産および製造技術等の全ての権利を譲り受けることにいたしました。

２．契約の内容

(1) 譲受の内容

①液体・粘体充填機開発・設計資料（図面、仕様書、取扱説明書　他）
②無体財産権（特許権、商標権、意匠権　他）
③その他上記に関連する一切の資料、財産

(2) 譲受価格

金２５０，０００，０００円

(3) 日　程

平成１８年 ９ 月 ８ 日　取締役会
平成１８年 ９ 月 ８ 日　譲受契約締結

３．今後の体制

液体・粘体充填機の開発につきまして、今後は自社での開発を進めてまいります。なお、販売および保守メンテナンスにつきましては、従前と変わらず当社が業務を継続いたします。

以　上